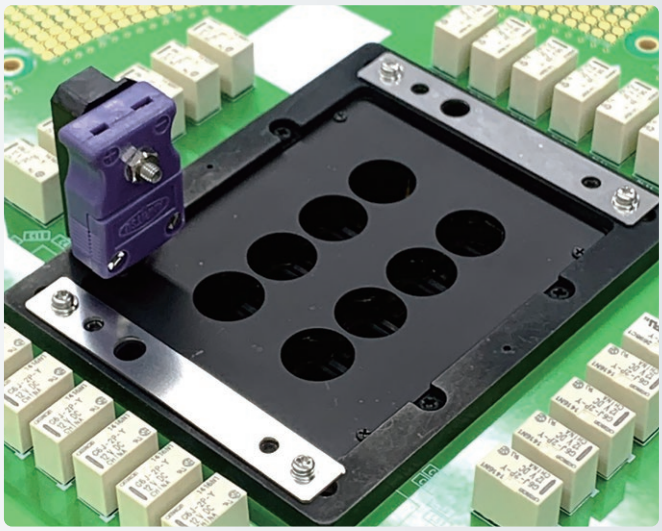
Nidec
All for dreams

特許出願中
Patent pending

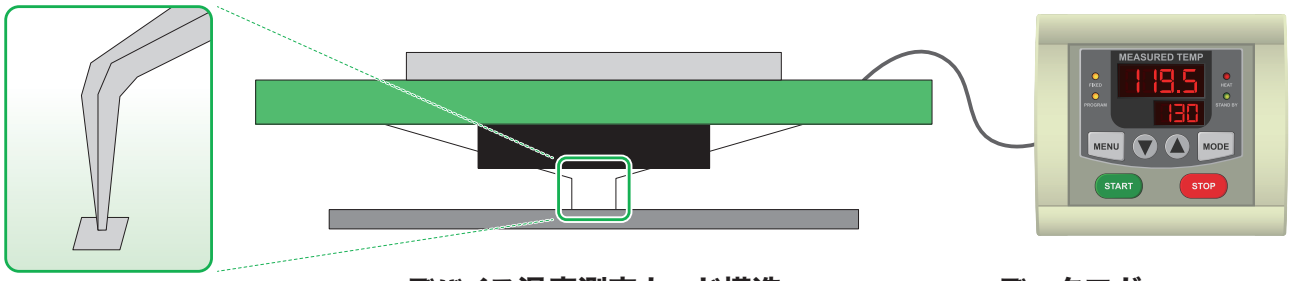
TC-Probe
デバイス温度測定プローブ
Device Temperature Measurement Probe



● カード外観 Card appearance

- 熱電対技術をプローブへ適用
  Applying thermocouple technology to probes
- 各デバイス温度を正確に測定
  Measures accurately the temperature of each DUT
- 既存PADへのコンタクト可能
  Contact on existing pads possible
- ウエハーテスト温度範囲をカバー
  Covers wafer test temperature range

■TC-Probe



デバイス温度測定カード構造
Device Temperature Measurement Card Structure

データロガー（お客様準備）
Data Logger (Prepared by customer)

カード仕様 | Card Specifications

先端面径 Tip Diameter	≥φ24um
先端形状 Tip Shape	フラット Flat
針位置 Alignment	±5um
高さバラツキ Planarity	10um
針圧 Probe Force	1.8gf @OD60um
最小ピッチ Min Pitch	60um
温度 Temperature	-40 ～ 200℃

ニデックアドバンステクノロジー株式会社
NIDEC ADVANCE TECHNOLOGY CORPORATION